# 精密加工におけるAE信号解析と信頼性の向上に関する研究

# 船田 昌・木下和久\* ・姫野敏彦\* 機械電子部・\*大分大学 工学部

# Investigation on Analysis of AE-signal and Improvement of Reliability in Precision Machining

Masashi FUNADA · Kazuhisa KINOSHITA\* · Toshihiko HIMENO\* Mechanics & Electronics Division · \*Faculty of Engineering,Oita University

#### 要旨

ファインセラミックス等の難削材の高精度研削加工の自動化と高能率化を実現するためには、インプロセスでの加工状態の把握と,難削材の研削に使用されるダイヤモンドホイールのツルーイング法の確立をしなければならない.

本研究は、平成8~10年度において上記2項目についての研究を行うが、今年度はインプロセスで加工状態 を把握する手法であるアコースティック・エミッション(以下AE)計測法について、基礎的実験である単粒圧 子押し込み実験と単粒引っかき実験を数種の被削材料に対して行った。AE信号を解析した結果、異なる被削材 料においてAE信号の発生に特徴が見られた。また、脆性破壊の材料除去域でのき裂伝播のモードが明確になっ た。

#### 1. 緒言

近年、ファインセラミックスの適用範囲が広がり、製品形状の複雑化と用途に応じて、二次加工が必要になっている<sup>(1)(2)</sup>.その際に発生するき裂は目視できないものが多く、表面性状を知る方法は走査電子顕微鏡(SEM)等による観察が主である。また、加工表面下部へ向かって進展するメディアンクラック等は確認が困難で、 顕微鏡による観察では加工後にしか状況を知る事ができない。

この様な状況において,加工能率の向上のためには, インプロセスで加工状態を知る方法が必要とされており, その手法の一つとしてAE計測法がある。しかしながら, AEの発生機構は十分に解明されるには至っておらず, 研削過程との直接的な対応が付けにくいのが現状である.

本研究では, 脆性破壊に関する理解をより深め, 研削 機構を定量的に解明することを目的として, き裂に関す る情報を多く含んでいると考えられる単粒圧子押し込み 実験を行った.また, 研削における基礎的モデルである 引っかき実験を行い, 研削抵抗, およびAEの解析結果 をあわせて検討した.

#### 2. 実験方法

#### 2.1 AE計測システム

AE計測システム線図をFig.1 に示す。AE変換子は

PZT圧電素子を使用し、グリースを媒体としてテーブ ルに固定した.研削によって発生したAE波は変換子で 電気的信号に変換された後、プリアンプによって増幅さ れ、ディスクリミネータによりノイズの除去が行われる. デジタルオシロスコープは、検出波をリアルタイムで観 察でき、圧子と試験片との接触状態の観察、AEセンサ 接触状態の検査等にも利用した.システムで離散化され たデータは磁気テープに記録された後、インターフェー スを介してパーソナルコンピュータに転送され、解析さ れる.

#### 2.2 ダイヤモンド単粒押し込み実験

き裂の進展によって発生するAE信号の特性を把握す るため、単粒ダイヤモンド圧子を用いて押し込み実験を 行った.試験片には窒化珪素、サイアロン、アルミナを 用いた.試験片の機械的性質をTable 1 に示す.任意の 荷重まで押し込み、圧子をその位置で10秒間保持した後、 0.164m/sの割合で荷重を除去し、その時のAE波形を記 録した.Fig.2 に装置の概略図を示す.

2.3 ダイヤモンド単粒引っかき実験

実験には平面研削盤を使用し,押し込み実験で用いた ダイヤモンド単粒を取り付けて行った。引っかき速度は 平面研削盤の外部からモータードライブを用いて送りを かけることで与えた。本研究では、引っかき速度を1.18 1mm/s の一定速度とした。任意の切込み深さについて観



Fig.1 AE計測システム線図

Table 1 試験片の機械的性質

材料	密度	ビッカーズ硬さ	曲げ強さ	破壞靭性値	ヤング率
	$(g/cm^3)$	(Hv)	(GPa)	$(MPa \cdot m^{1 \neq 2})$	(GPa)
SiAlON	3,26	15.5	0.88	6.0	127
Si3N4	3.36	18.0	1.10	5.0	314
Al203-TiC	4.25	24.0	0.80	4.4	420



Fig.2 単粒押し込み実験装置概略図

察,解析を可能にするために、わずかに勾配を付けたペ -スに試験片を接着しテーブルに取り付けた、これによ り、切込み深さはテーブルを送ることにより漸増する。 研削満の理論切込み深さは、試験片表面が平坦であると して、研削開始点からの距離と試験片の傾きにより算定 した。

#### 3.実験結果と考察

#### 3.1 ダイヤモンド単粒押し込み実験

Fig.3 にそれぞれの被削材の荷重除去時におけるパワ ースペクトルを示す。各被削材とも1.4MHz付近まで幅広 い周波数帯にパワーが現れており、材質の違いによる差 異は認められなかった.S45Cの荷重除去時にAE信号が 検出されず、荷重除去時においてはき裂の進展以外AE 源は考えにくいため、セラミックスの脆性破壊時に検出 されるAE信号のパワースペクトルは1.4M比付近まで幅 広い周波数帯をもつことが推察される.また、Fig.3 に おいて時間的推移は示されていないが、圧子が材料に進 入するに従って全体的にパワーは増加した.セラミック スの荷重除去時に発生するき裂は、圧子直下から圧子を 中心に周囲へ広がっていき、被削材表面にまで達すると 考えれば、全体のパワーの増加はき裂の発生規模になん らかの関係を持つものと考えられる.

Table 2 はそれぞれの被削材において荷重除去時に突 発型AE信号が発生する最低荷重を示したものである. この結果はTable.1 に示す各被削材の破壊靭性値に対応 している.

Fig.4 はサイアロン,窒化珪素,アルミナの任意の荷 重除去時の累積オシレーションカウントをグラフに表し たものである.

若干のばらつきがみられるが圧入荷重が増加するに従って累積オシレーションカウントは増加する傾向がみられ、また、同一荷重における累積オシレーションカウントは、アルミナ>窒化珪素>サイアロンの順であることがわかる.これは、破壊靭性値との対応が認められる.



Fig.3 単粒圧子押し込み実験のパワースペクトル

材料	最低荷重(N)			
SiAlON	80.4			
Si3N4	57.5			
Al2O3-TiC	33.3			

Table 2 AE信号発生の最低荷重



### 3.2 ダイヤモンド単粒引っかき実験

Fig.5 はアルミナ,窒化珪素における引っかき試験の 切込み深さを示したものである。切込み深さは粗さ計を 用いて0.5mm 間隔で加工痕長さを直角方向に測定した。 窒化珪素においては実測切込み深さには,ばらつきは見 られなかった。これに対し、アルミナでは理論切込み深 さ5.5µm 近傍からばらつきが大きくなっている。



Fig.6 に窒化珪素を被削材とし、切込み深さを漸増さ せながら研削したときの法線研削抵抗の挙動を示す. 一 般にセラミックスの研削において、法線抵抗(Fn)に比較 して接線抵抗(Ft)はかなり小さい<sup>(3)</sup> ことから本実験で は法線研削抵抗のみに注目した.

Fig.6 において、切込み深さが深くなり延性領域から 過渡領域へと遷移するに従い研削抵抗に乱れを生じ始め、 その乱れは過渡領域から脆性領域へと遷移するにつれ大 きくなっていることが確認される.また、このとき検出 されたAEのパワースペクトルを研削抵抗の特定箇所と 対比させて示す(Fig.7 (a)~(b)).

Fig.6の(a),(b)部では研削抵抗が増加しており,パワ ースペクトルも0~0.35MHzの領域でパワーの盛り上がり を生じている.そのほか,0.4~0.8MHz 付近の周波数帯 において若干パワーの増加が確認され,き裂の進展によ り発生すると考えられる1.4MHz近傍までの幅広いパワー の出現は認められない.なお,これについては,さらに データの蓄積が必要である.切込み深さの浅い塑性変形 による材料除去域においてAE信号が検出されなかった ことを考慮すると,このときの研削抵抗の増加域は,塑 性変形と共に微細き裂を生じる領域だと考えられる.

Fig.6(C)部では研削抵抗が減少しており、このときの パワースペクトルは0~1.4MHz 付近までの幅広い範囲の 周波数帯にパワーが出現し、そのパワーは研削抵抗が減 少するに従い増加している。き裂の進展により現れると 思われる周波数帯の存在、またその地点での表面性状等 を考慮すると、研削抵抗減少域は、切れ刃に先行してき 裂が伝播する脆性破壊型の材料除去を行う領域であると



Scratching distance from starting point [mm]

Fig.6 法線研削抵抗の推移



推測される。

以上のことから, 脆性領域は, 塑性変形と共に微細き 裂を生じる領域と, 切れ刃に先行してき裂が伝播する脆 性破壊型の材料除去を行う領域が交互に現れる断続切削 の状態にあると思われる. なお, これらの現象は異なる 材質, 引っかき速度でも確認された.

## 4. 結論

- (1)荷重除去時において突発型AE信号が発生する最 小圧入荷重は大きい方からサイアロン>窒化珪素> アルミナの順であり、これは破壊靭性値に対応して いる。
- (2)荷重除去時に得られる累積オシレーションカウン トは、同一荷重では多い方からアルミナ>窒化珪素 >サイアロンの関係にあり、荷重が増加するに従っ て累積オシレーションカウントも増加していく.
- (3) 切込み深さが漸増していくとき、加工痕表面性状 は延性領域/過渡領域/脆性領域と遷移していく. 同一引っかき速度では、窒化珪素に比ペアルミナの ほうが浅い切込み深さで遷移が行われる。
- (4) 脆性破壊型の材料除去域では
  - I。塑性変形と共に微細き裂を生じる領域
  - Ⅱ. 切れ刃に先行してき裂が伝播する脆性破壊の領域

の二つのモードが交互に現れる断続切削の状態にあ り、これは研削抵抗の乱れ、パワースペクトルの挙 動から判断できる.研削抵抗が増加域で、0~0.8 MHz の周波数帯にパワーが認められたときモード I の状態にあり、研削抵抗が低下域で、0~1.4 MHzの 周波数帯にパワーが認められたときはモード II の状 態にある.

## 参考文献

- 1) 稲崎,ファインセラミックスの研削加工,機論,56, 530,C1-5(1990)
- 2) Y. Jong, I. Inasaki, S. Mastui, "Basic Study on High Efficiency Grinding of Advanced Ceramics", JSME, 53, 485, A209–16(1987)
- 3) 杉田,上田,島田,石川,伊藤,セラミックスの機 械加工,養賢堂

#### 付録

AE信号の再現性を調べるために、サイアロンとアル ミナについて実験を行った結果、以下のことが明らかに なった(Fig.A-1, Fig.A-2).

- (1)単粒研削実験において、被削材が同じで、同一の 研削痕において切込み深さがほぼ等しい場合、AE の波形パターンは類似する。
- (2) 切込み深さがほぼ同じとき、パワースペクトルは 低周波領域において高い類似性を示す。
- (3) 切込み深さが増加した場合、AE波形は振幅、周 波数とも変化するが、パワースペクトルの比較においては、0~0.97MHz近傍の低周波領域での増加として現れる。
- (4) 異なる2本の研削痕においても、切込み深さがほ ぼ等しい場合には、AEの波形パターンは高い類似 性を示す。
- (5)(1),(4)の結果,切込み深さがほとんど等しい場合,同一被削材での比較においては,AEの波形パ ターンは類似性があり,再現性には問題がない.
- (6) 被削材が異なる場合には当然予想されるように, 切込み深さが等しいにも関わらず,2つの波形には 顕著な相違が認められる.









Fig.A-2 AE波形(異種被削材,同一切込み深さ)